

VP _ Easy 500 Brasage compacte à phase vapeur

Le système de refusion à phase vapeur permet le soudage parfait même avec les pâtes **sans plomb** de cartes SMT complexes. Les composants CMS comme QFP, BGA, Flip-Chip ainsi que des unités céramiques sont soudées dans la plus haute qualité. La **construction compacte** permet la mise en service rapide. Le service ne demande que la tension de 380 / 400 V.

Les avantages

- Système de refusion **avantageux** pour l'avenir technologique sans plomb
- Préchauffage et soudage **sans oxydation**
- **Distribution régulière de température** dans la chambre de process
- Conditions de service **reproductibles**
- Coûts bas et avantageux
- Pas de programmation de profils de températures

Le processus

On pose la carte facilement sur le support et démarre le processus. Les objets à souder jusqu'à 500 x 500 mm sont portés à la position de brasage par mouvement motorisé. La commande PLC / API contrôle le processus de soudage selon la température programmée. Après le processus les cartes sont retournées à la position de refroidissement. La fin du processus est signalisée après le refroidissement et la carte est libre pour l'enlèvement.

Concept de l'équipement

L'installation de l'équipement est **possible à chaque endroit**. La commande électronique contrôle les températures de chauffage, de liquide et de vapeur et permet un service sans intervention. La reconnaissance du liquide utilisé est automatique. La soudeuse est équipée d'un système fermé de climatisation et d'un groupe de refroidissement.

Spécifications VP-500 Easy

Dimensions max. PCB	500 x 500 x 120 (h) mm
Temps de cycle env.	6 min
Température processus réglable,	max 240°C
Quantité du liquide	env. 3 kg
Consommation moyenne	env. 1 gr. / cycle
Tension	380V; 50 Hz
Puissance	6 kW
Dimensions	750 x 750 x 1100 (h) mm
Poids env.	200 kg

